(1) 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 4769

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)1月10日

C 09 J 5/00 B 29 C 65/52H 05 K 3/46

6770 - 4 J7365 - 4F

6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称

平面状導体基板の貼り合せ方法

21)特 頤 昭60-143934

22)出 願 昭60(1985)7月2日

79発 明 者

鈴 木 喜 彦 日向市竹島町1番地の1 旭化成工業株式会社内 日向市竹島町1番地の1

旭化成工業株式会社内

明 者 勿発 願 创出 人

Ш 7/5

亮 亚 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

明 細

1. 発明の名称

平面状導体基板の貼り合せ方法

2. 特許請求の範囲

2枚の平面状導体基板どうしを貼り合わせる場 合に予め2液性接着剤の主剤を一方の基板の被接 着面に、また硬化剤を他方の基板の被接着面にそ れぞれ塗布しておき接着を希望する時期に及んだ 際にそれぞれの基板を密着させることを特徴とす る平面状導体基板どうしの貼り合せ方法

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は印刷回路等の平面状の導体部を有する 基板どうしを貼り合わす方法に関する。

(従来技術とその問題点)

従来、2液性の高粘度の接着剤を用いて平面状 導体を貼り合わせる場合は、貼り合わせる直前に 主剤と硬化剤を混合しそれを硬化が始まらないう ちに一方の基板の被接着面、または両方の基板の 被接着面に手早く塗布して貼り合わせるという手 段を採用していた。

しかしながら、基板どうしの接着作業を大量に かつ連続的に行う場合には従来法は非常に手間が かかり非能率的である。いったん混合した2液性 の接着剤はすぐに硬化が始まるため作業の流れを 十分に調整・監視しながら混合の時期を見図らね ばならない。また使用する接着剤量が多いため主 剤と硬化剤を混合するための場所と労力もかなり 必要である。さらに混合した接着剤のうち実際に 貼り合わせに使用されずに硬化してしまい無駄に なる接着剤量も少なくない上、これら硬化した接 着剤が大量に付着した混合用装置、道具類の洗浄 等の始末も大変な手間を要する。また混合済みの 接着剤の被接着面への塗布はプレードコーターや ローラーコーターなどで被接着面の一方から他方 へ向かって塗り広げていくため、広い面に塗布す る場合には塗り始めと塗り終わりの頃では接着剤 の硬化度が異なってしまい、また多くの回数塗布 する場合に初めの頃と終わる頃でも接着剤の硬化 度が異なってしまい接着効果にむらを生じ易い。

さらに、薄く均一な厚みの接着剤層を得るために、2液性接着剤を混合後片側の基板に薄く塗布しそれに別の基板を貼り合わせると接着剤層に大小の気泡を含んでしまい、それにより接着力が低下してしまう。

(発明の目的)

本発明は以上に示したような問題点を解決し、 2 液性接着剤を用いて平面状導体どうしを接着剤 の効果時間に左右されることなく、手際よく、し かも接着ムラを起こさずに貼り合わせる方法を提 供するものである。

(発明の目的を達成するための手段)

すなわち、本発明は2枚の平面状導体基板どう しを貼り合わせる場合に、予め2液性接着剤の主 剤を一方の基板の被接着剤にまた硬化剤を他方の 基板の被接着面にそれぞれ塗布しておき、接着を 希望する時機に及んだ際に主剤が塗布された一方 の平面状基板面と硬化剤が塗布された他方の平面 状基板面とを密着させることを特徴とする平面状 導体基板どうしの貼合せ方法である。

さらに、特に薄型の接着基板を得るためには一方の基板に主剤、もう一方の基板には硬化剤をスクリーン印刷で薄く塗布しておき、両者を接触させて貼り合わすか、または各剤を比較的厚めに塗っておき貼り合わせ時に加圧し余分な接着剤を基

本発明でいう平面状導体基板どうしとは、真に 平面状の基板どうしの他、互いにかみ合う形状の ゆるやかな曲面状の基板どうしをも含む。

2 液性の接着剤は一般に主剤と硬化剤を適量比で混合した場合に接着効果が発揮されるからない。 り合わせ時に両剤が適量比のもとで過不足な面に強痛するのがよい。 すなわち使用する 2 液性接着剤に固有の最も好ましい主剤と硬化剤の配合比をそれぞれの基板への主剤および硬化剤の塗布厚からは大き剤と硬化剤は互いに接触させると接触面から拡散によって徐々に硬化し、接着剤層を形成する。

なお、使用する 2 液性接着剤はいかなる配合比 のものでもよいが、配合比 1 対 1 のものが特に好 ましい。

また各基板に主剤または硬化剤を均一に適量を 塗布する方法としてはとくに限定されないが、ス クリーン印刷法を用いるのが好ましい。ナイロン

板外にはさみ出させて行う方法がある。好ましくは最終的に得られる接着剤層の厚さが主剤層の厚さや硬化剤層の厚さより小さくなる程度に加圧する。そうすることにより最終的に接着剤層が薄くなるのみでなく、硬化反応を促進し、接着力のムラが生じにくくなる。

以下に本発明の実施 態様を挙げるが、本発明は これらに限定されるものではない。

(実施例)

ガラスエポキシ製基板上に鋼箔を貼りつくられた印刷回路基板にオーバーコート用の絶縁ワニス(日立化成株式会社製WI-640)を塗布後乾燥し、硬化させた。この印刷回路基板をそれぞれのオーバーコートを合わすように貼り合わせるために、まず2液性接着剤(セメダイン株式会社製SG-EPOEP-007)の主剤を片方の印刷回路基板のオーバーコート面の上にスクリーン印刷で塗布した。ただし、スクリーン印刷において、スクリーンはテトロン製の300メッシュのもの、またスキージはウレクン製の硬度60°のものを角度75°にセッレクン製の硬度60°のものを角度75°に

トし 4.5 cm / 秒の速さで塗布を行った。100 枚の基板に塗布を行ったところ、スクリーンの網目を通った主剤は100 枚とも平均厚み30 μm に塗布された。

また硬化剤を主剤と同様に塗布したところ、硬化剤の塗布厚みは100枚とも25μmで塗布された。 塗布後の主剤並びに硬化剤は脱泡のために、60℃で30分間加熱した。

このようにしてできた一対の基板どうしを重ね合わせ、次々にプレス式加熱機に設置し、2.0 kg/cdで加熱し、また100 ℃に加熱し40分放置した。そる結果、接着剤の一部は外に押し出され、厚さ50μmの均一な接着剤層をもつ平面状導体の積層体が100 枚得られた。その接着剤層中には接着むらの原因となる気泡は見られなかった。

(比較例)

ガラスエポキシ製基板上に網箔を貼りつくられた印刷回路基板に実施例と同様に絶縁ワニス(日立化成KK製WI-640)を塗布後乾燥し150℃30分で硬化させた。

合わせ、次々にプレス式加熱機により20Kg/cml100 でで40分加熱した。

その結果、初めに塗布した基板は接着剤が外に押し出され厚みが50μm±20μm 程度になったが100 組全体としては75μm±45μm になった。また随所に気泡によるふくれが生じていた。

(発明の効果)

次に2液性エポキシ接着剤(セメダイン株式会 社製SG-EPO EP-007) の主剤と硬化剤を混合した。 特に硬化剤の粘度が高いため、主剤と硬化剤の混 合中に多量の気泡が混入した。そこで一部温度を あげて粘度を上げ脱泡するために60℃で加熱した が、10~20分では脱泡が始まらず、30分以上にな ると硬化が始まり粘度がかえって高くなりばじめ た。そのため、一応60で20分加熱後、テトロン製 300 メッシュのスクリーンを用い、スキージはウ レタン製の硬度60°のものを角度75°にセットし、 4.5 cm/ 秒の速さで上記のガラスエポキシ基板の 両方接着予定面に各100 枚づつ塗布を行った。計 200 枚塗布するのに約3 時間かかったが塗布開始 後、1 時間30分を経過してから硬化のためか粘度 が高くなり、膜厚ムラが大きくなり結局平均で27 μπ であったが、特に後半の塗布厚は目で見てわ かるほどムラが大きかった。また使用したスクリ - ンは、接着剤が硬化してしまいアセトン等を用 いても洗浄ができず、再使用不能となった。

このようにしてできた一対の基板どうしを重ね